



1. 冲击和振动

请勿施加过大的冲击，如运输、基板安装或意外跌落或敲击或超过规定的机械振动。否则，可能会导致晶片破裂或损坏所用部件导致无法使用。施加超过规定的冲击、震动时，请务必进行特性确认。

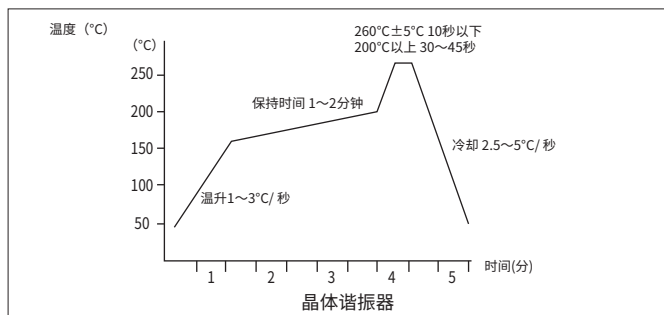
2. 清洗

晶体元件在进行超声波清洗的时候晶片有时会被共振破坏。进行超声波清洗时，请务必事先确认。清洗后请将产品完全干燥。产品和贴装板之间的水滴可能导致焊接偏移。

3. 焊接条件

为提高产品的可靠性，请在建议条件的范围内使用。

■推荐回流焊曲线



※推荐的回流温度条件取决于产品。
相关详细信息，敬请咨询我司销售窗口。

■标准烙铁焊接的条件

晶体谐振器	
烙铁焊接温度	280° C ~ 340° C
时间	3+1/ - 0秒以内

4. 贴片注意事项

基板的焊盘和产品的电极在表面上焊接。极端的基板变形会导致焊盘剥落、产品电极剥落、焊料龟裂和产品封装部分的损坏，性能可能会下降或导致无法工作，请在规定的弯曲条件下使用。特别是在贴片后拆分板时，如果您将产品贴在基板上的经线很大的位置，请小心。

使用自动贴装机时，请尽量选择冲击小的机型，确认没有破损后再使用。

表面贴装型晶体元件不支持波峰焊接。请小心轻放。

5. 储存

长时间的高温和低温的保管以及高湿度的保管，会导致频率精度的劣化和焊接性的劣化。储存场所请保证温度、湿度为-5°C~+40°C，且相对湿度为40~60%RH，并且请远离直射，在6个月以内使用。

